

株式会社東京精密 2018年度(2019年3月期) 決算説明会

2019年5月14日

*

◆ 将来の事象に係わる記述に関する注意

- 本資料に記載されている情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。
- これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。
- 従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

◆ 表記データ・用語について

- 注記がある場合を除き、半導体製造装置セグメントを「半導体」、精密計測機器セグメントを「計測」、また親会社株主に帰属する当期純利益を「当期純利益」と記載します。
- 記載されている金額や比率の情報は、注記がある場合を除き、億円またはパーセントによる要約表示を行っております。その為、内訳の計が、合計と一致しない場合があります。

◆ 監査について

- 本プレゼンテーション資料は、監査法人による監査の対象外です。

次第

- ◆ 2018年度 業績説明
- ◆ 中期目標 初年度総括
- ◆ 中期目標 今後について
- ◆ 2019年度業績予想
- ◆ 質疑応答

2018年度 通期業績



単位：億円(配当除く)	2017年度	2018年度	
	通期実績	通期実績	前期比
売上高	882	1,015	+15%
半導体製造装置	595	691	+16%
計測機器	287	324	+13%
営業利益	173	202	+17%
半導体	113	132	+17%
同率	19%	19%	
計測	60	70	+17%
同率	21%	22%	
経常利益	173	208	+20%
当期純利益	127	147	+15%
1株配当	92円	125円(含 記念配当)	+33円

➤ 2018年度は、両事業とも堅調、創業来最高の売上および利益となった

May 14th, 2019

Copyright 2019

Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

All rights reserved.

4

- 2018年度は、堅調な事業環境を主因に創業来最高の売上・利益を達成
 売上高 1,015億円(半導体691億円、計測324億円)
 営業利益 202億円(同132億円、70億円)
 経常利益は208億円、当期純利益は147億円
- 1株配当は125円(創業70周年記念配当を含む。期末配当は66円)
 (33円増配。詳細は2019年5月14日付ニュースリリースをご覧ください。)

2018年度 第4四半期業績



単位: 億円	2017年度				2018年度					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比 Q/Q	前年同期比 Y/Y
売上高	199	238	192	253	198	314	237	266	+12%	+5%
半導体製造装置	142	161	126	166	128	230	153	180	+18%	+8%
計測機器	57	76	67	87	70	84	84	86	+2%	-1%
営業利益	40	49	36	48	31	71	48	52	+9%	+9%
半導体	31	32	22	28	16	52	31	33	+8%	+19%
同率	22%	20%	17%	17%	13%	23%	20%	18%		
計測	9	17	14	20	15	19	17	19	+10%	-5%
同率	16%	22%	22%	23%	21%	23%	21%	22%		
経常利益	41	49	36	46	34	74	48	52	+9%	+13%
当期純利益	29	35	26	38	26	53	35	33	-6%	-13%

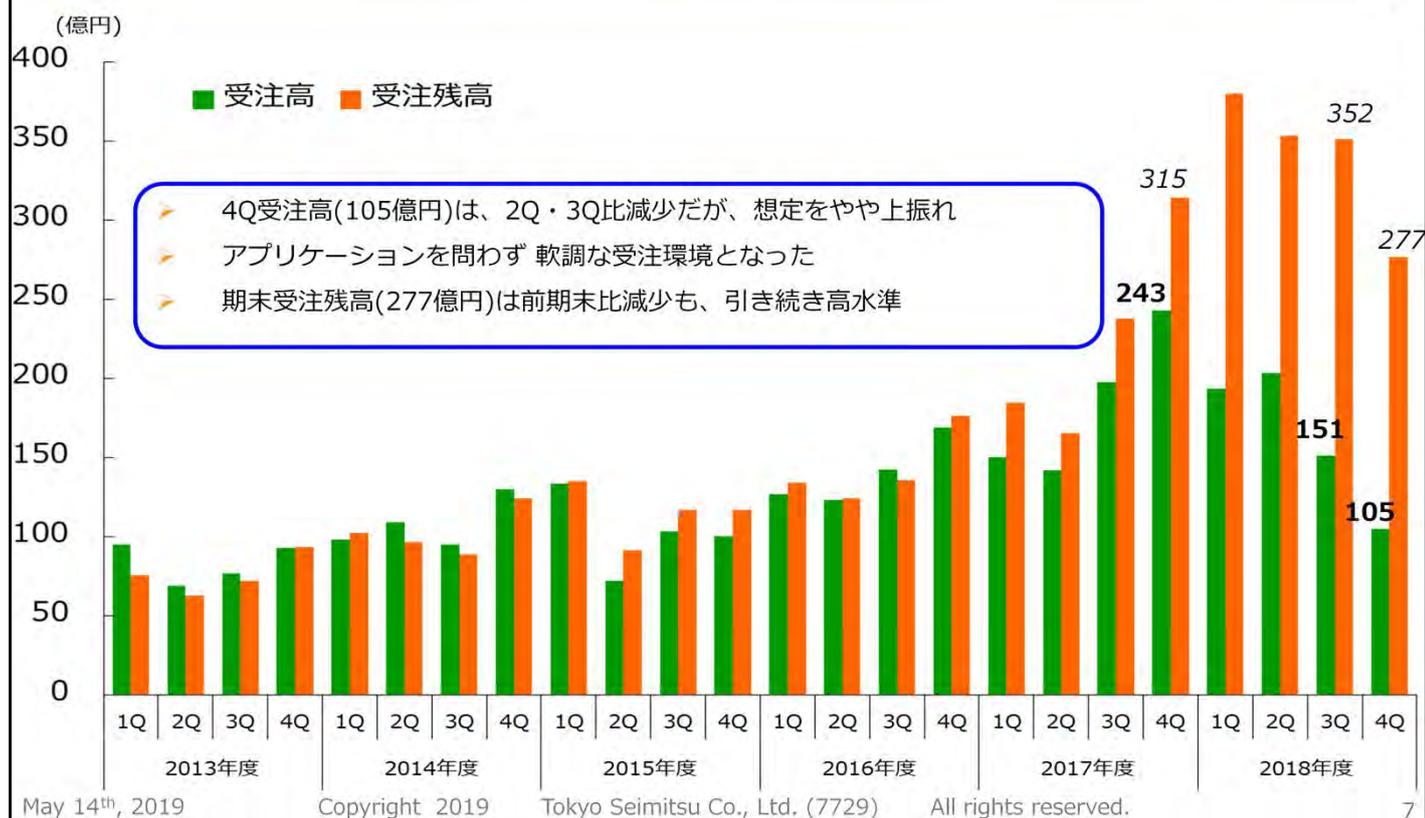
- 2018年度第4四半期(1-3月、以下4Q)の業績概要
- 売上高 266億円(半導体 180億円、計測 86億円)
半導体は計画通りの出荷、計測は安定した需要を主因に
前四半期比、前年同期比 いずれも増収
- 営業利益 52億円(半導体 33億円、計測 19億円)
- 経常利益 52億円、 当期純利益 33億円

半導体 - 売上高, 営業利益



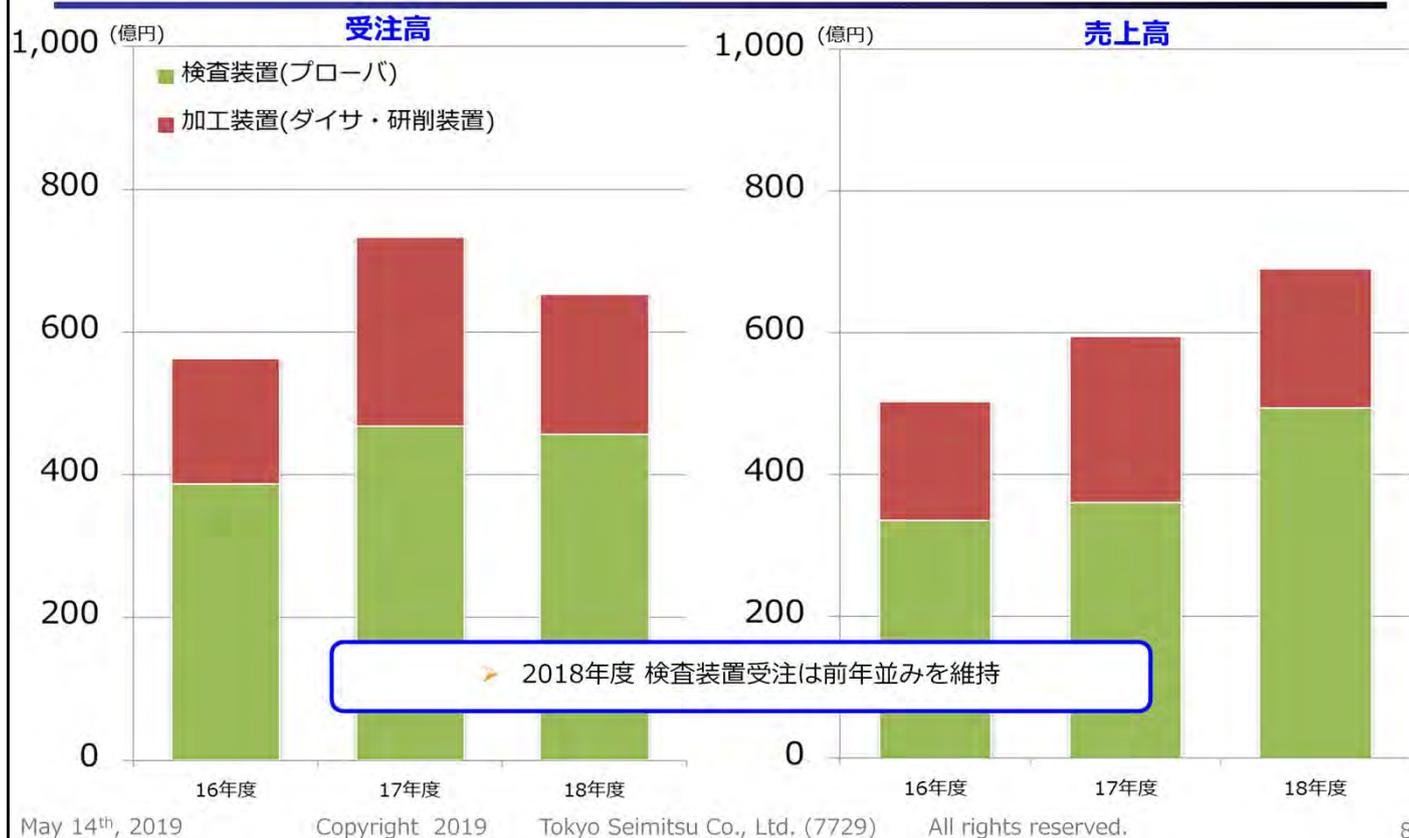
- 4Q売上は、ディスプレイドライバICやセンサをはじめとして出荷が予定通り進んだことから、想定線の着地
- 結果として、3Q比で増収となった

半導体 - 受注高, 受注残高



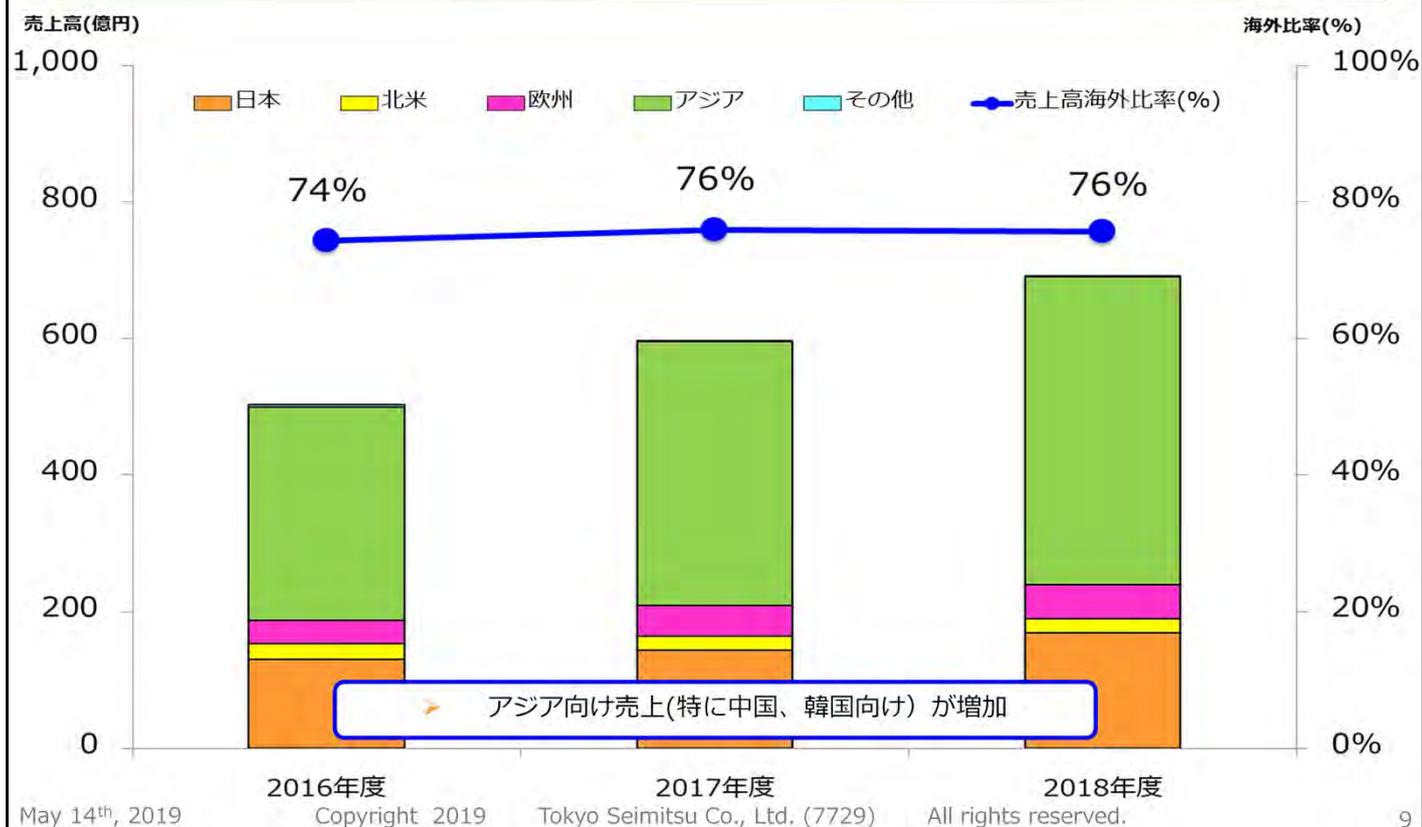
- 4Q受注高は105億円、前四半期比減少が続いたが、想定からはやや上振れ
- 2018年秋口からのメモリ投資減少に加え、アプリケーションを問わず軟調な推移
- 期末受注残高は277億円と、前期末・当期期中と比較して減少も、引き続き高水準
- 2019年度業績予想は、上記を前提としている

半導体 - 製品別動向



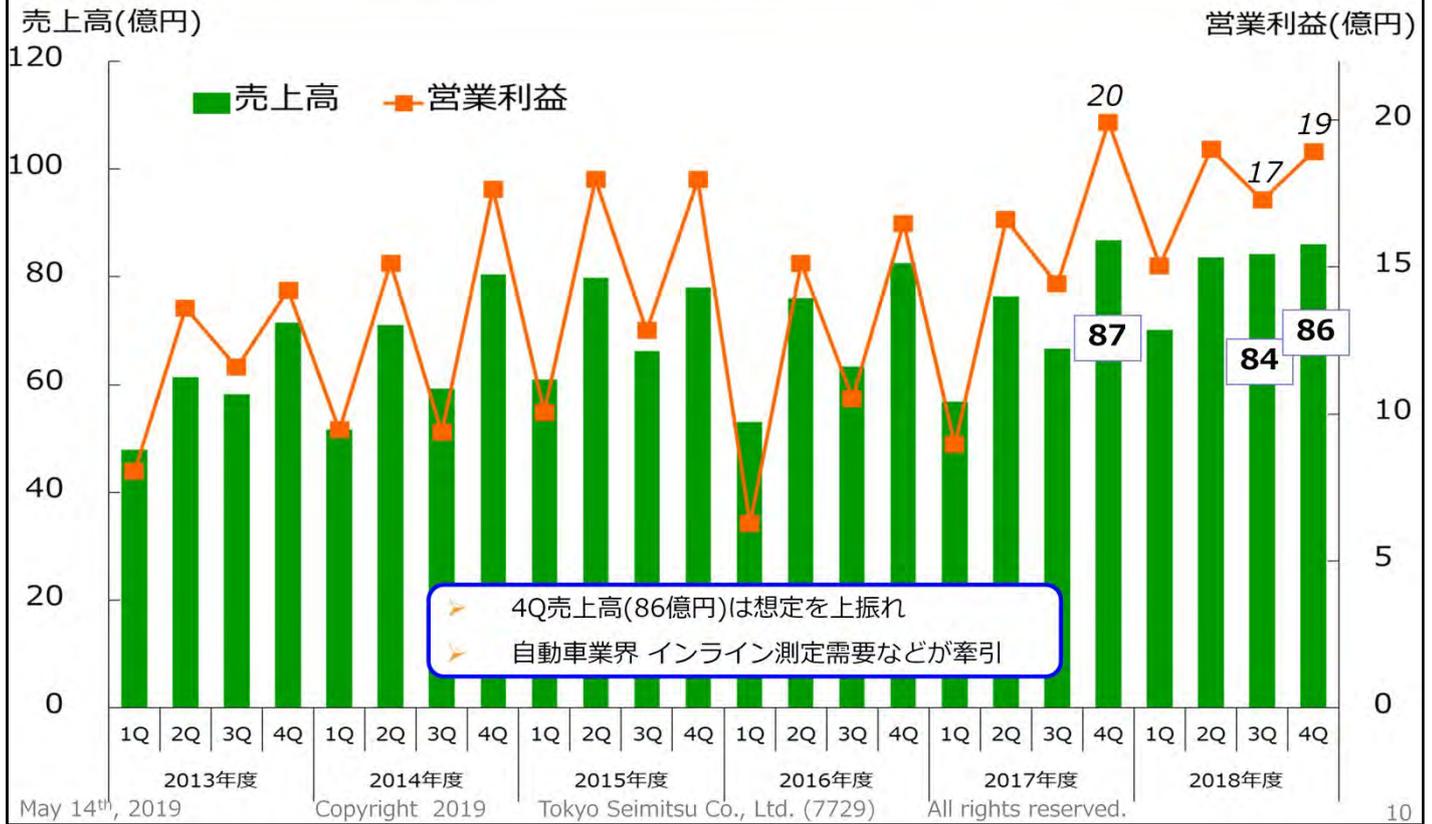
- 2018年度は検査装置（プローバ）は前年並みを維持したものの、加工装置（ダイサ、研削装置等）で受注が減少。
- 売上は特に検査装置が増加
- 製品構成比は、受注、売上とも、検査装置 ほぼ7割、加工装置ほぼ3割

半導体 - 地域別売上高



- 海外売上高比率は76%
- アジヤ向けが増加（特に東南アジア、韓国向け）国内向け売上も堅調

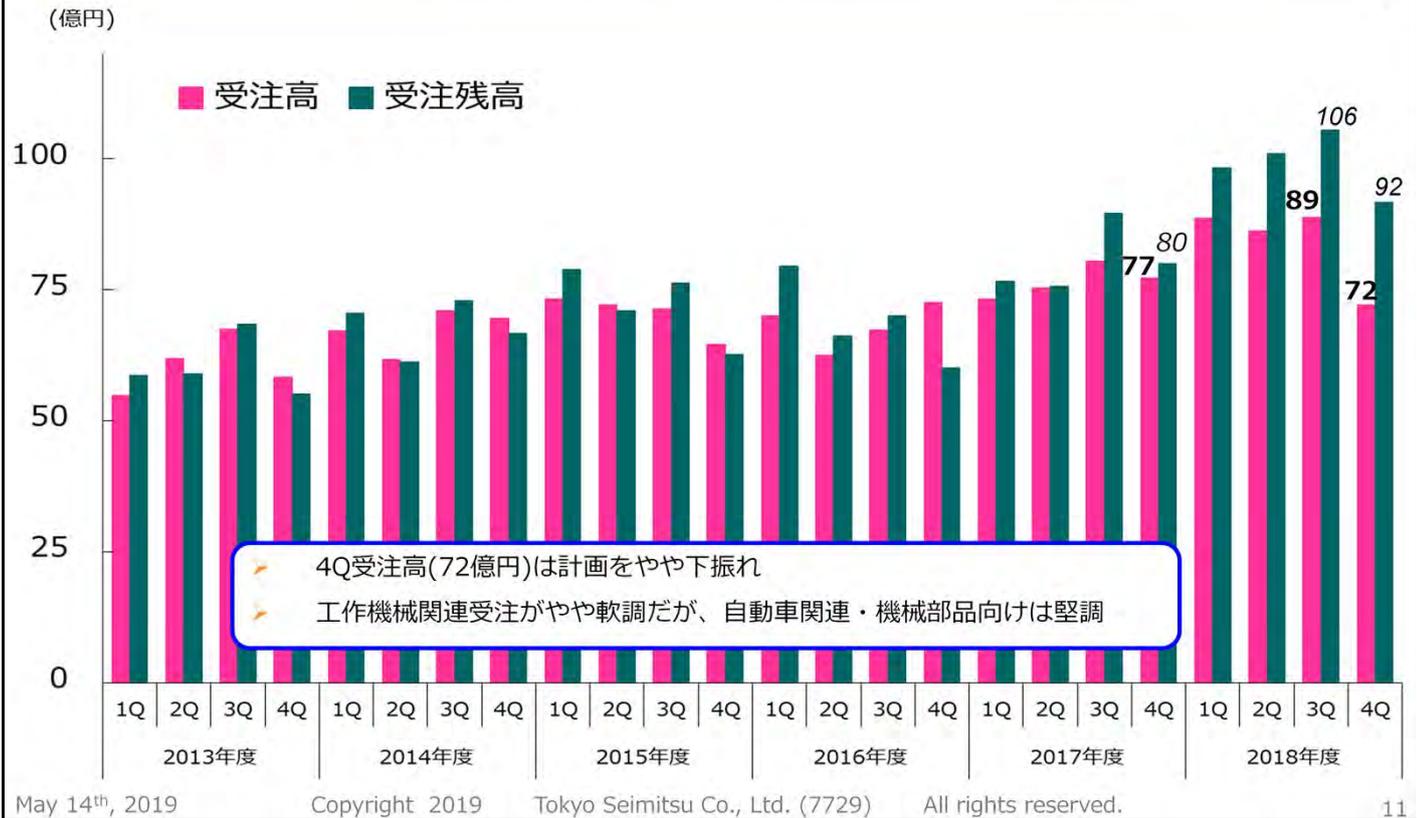
計測 - 売上高, 営業利益



○ 4Q売上は86億円、想定を上振れ

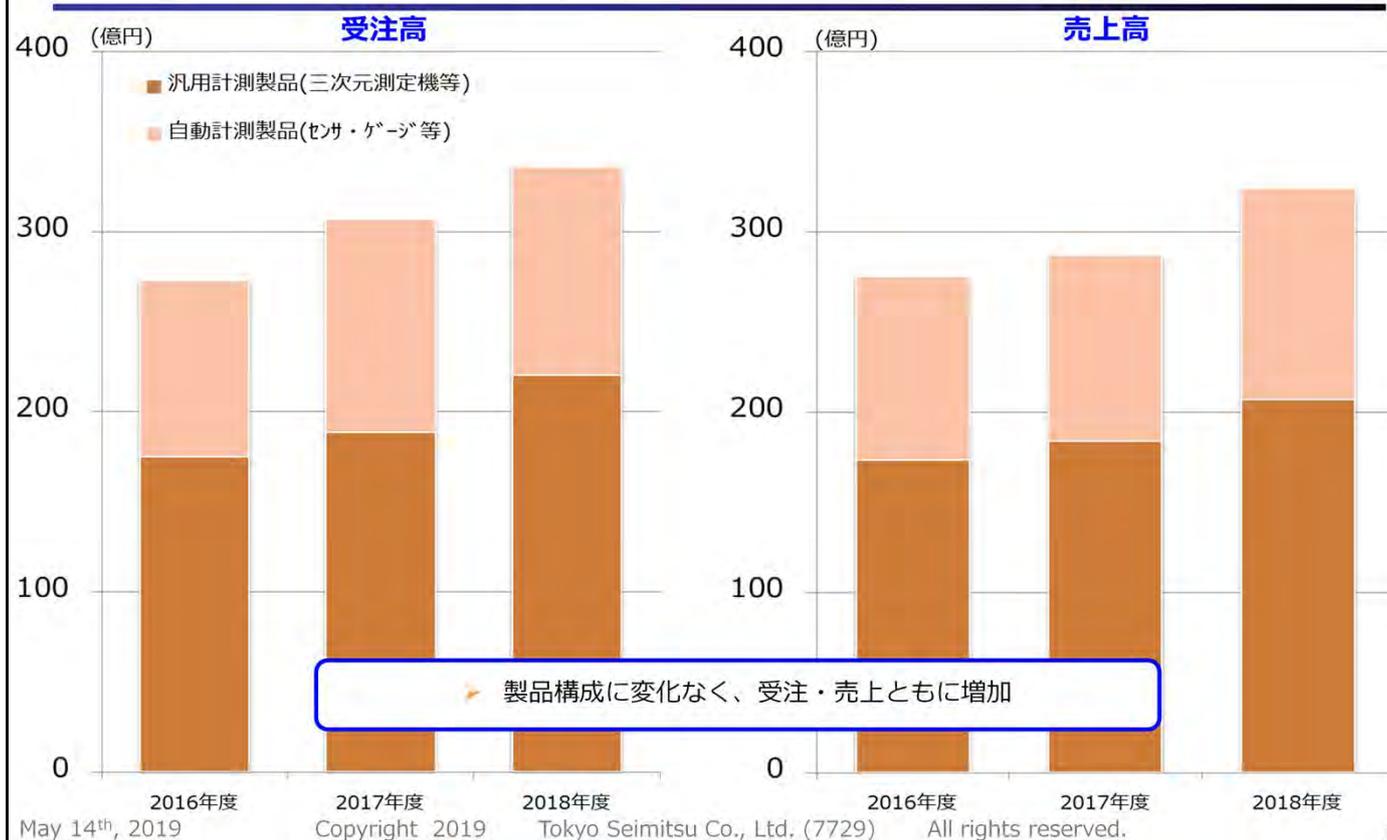
○ 自動車業界のプラットフォーム革新投資や、インライン測定需要が堅調

計測 - 受注高, 受注残高



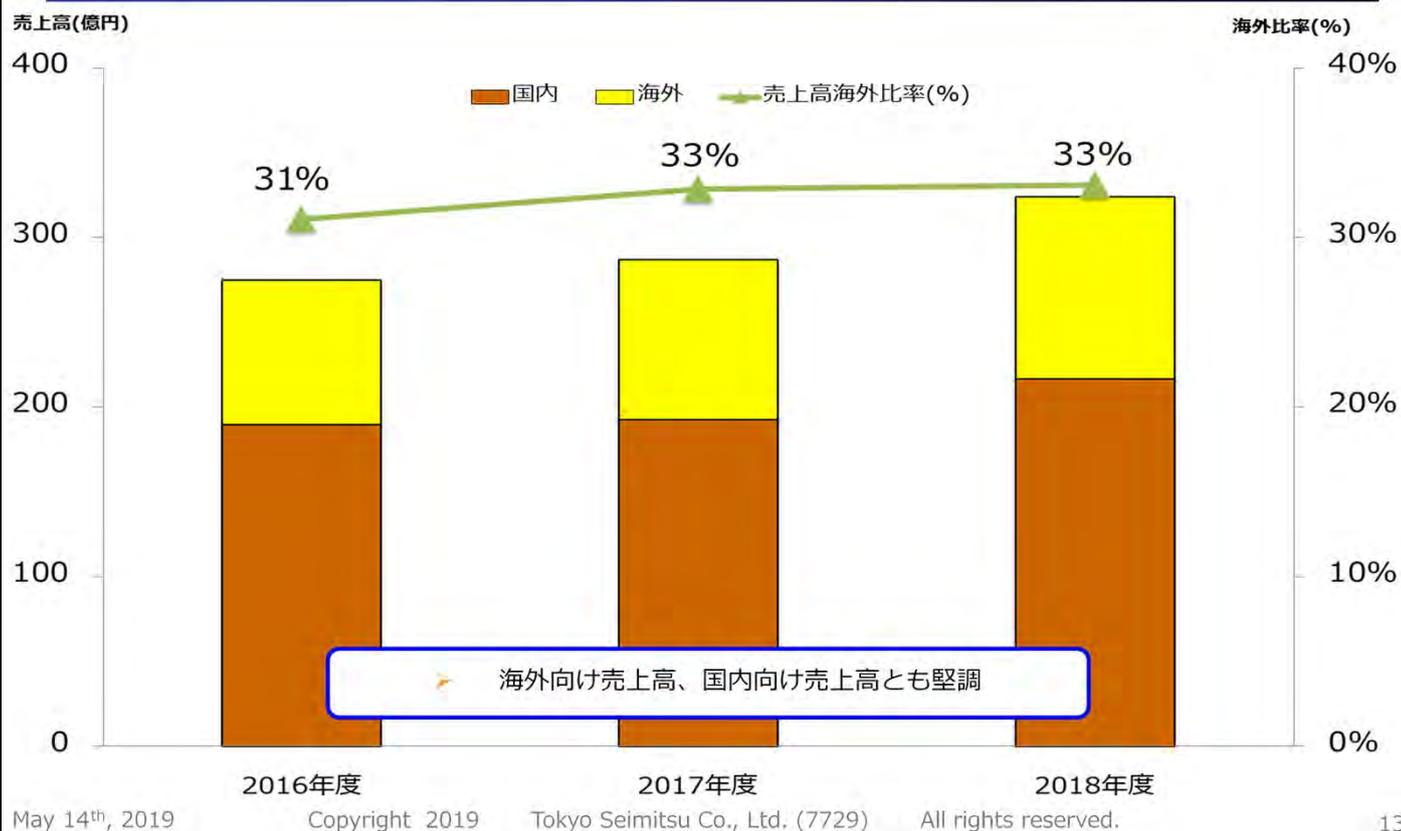
- 4Q受注高は72億円、想定をやや下振れ
(工作機械関連受注がやや弱くなったことが主因、ものづくり補助金発表タイミングの影響も多少受けた)
- 一方、自動車関連業界、機械部品(ベアリング等)関連業界の需要は堅調

計測 - 製品別動向



- 2018年度は受注・売上とも汎用計測製品（三次元座標測定機等）が期を通じて堅調
- 受注構成比、売上構成比とも、汎用計測 6割台半ば、自動計測 3割台半ば

計測 - 地域別売上高



- 2018年度 海外売上高比率は、33%で前年並み
国内売上高、海外売上高とも堅調に推移

貸借対照表



資産 (億円)	18/3末	19/3末	増減	負債/純資産 (億円)	18/3末	19/3末	増減
現預金	372	415	+43	支手・買掛金, 電子記録債務	219	263	+45
受取手形・ 売掛金・ 電子記録債権	334	361	+27	短期借入金, 1年内長期借入金	13	33	+20
在庫	223	300	+77	その他	96	113	+17
その他	20	24	+4	流動負債計	328	409	+81
流動資産計	950	1,101	+151	固定負債計	7	92	+85
固定資産計	379	475	+96	負債計	335	501	+166
資産合計	1,329	1,576	+247	純資産	994	1,074	+80
				負債・純資産合計 (内有利子負債)	1,329 (13)	1,576 (114)	+247 (+101)

May 14th, 2019

Copyright 2019

Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

All rights reserved.

14

- 3月末の総資産は1,576億円(前年3月末比247億円増)
- 資産増加の内訳は
流動資産が151億円増加(現預金43億円増、売上債権27億円増、在庫77億円増)
固定資産が96億円増加(土地取得など)
- 負債合計は501億円(買掛債務、借入金などを主因に166億円増加)
- 純資産は1,074億円(80億円増加)
- 自己資本比率は67.3%、3月末の有利子負債残高は114億円

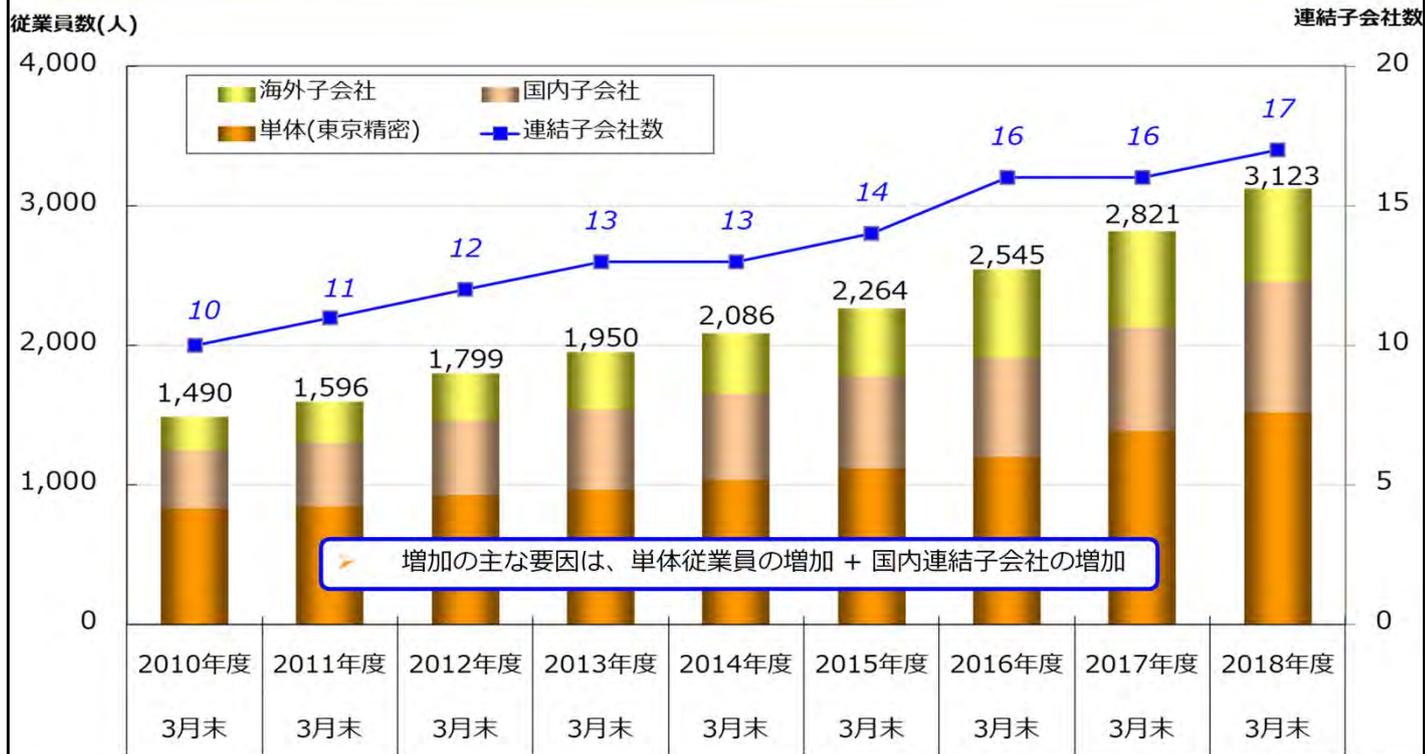
キャッシュフロー



単位：億円		2016年度	2017年度	2018年度
現金等 期首残高		273	338	371
営業活動	税引前・償却前利益	169	200	233
	(売上債権+在庫) - 仕入債務	- 1	- 42	-56
	納税	- 36	- 59	-58
	その他	- 4	11	10
小計		128	109	129
投資活動		- 35	- 46	-139
フリーキャッシュフロー		93	63	-10
財務活動	社債・借入	- 3	- 0	100
	株式・配当金、他	- 26	- 31	-45
	小計	- 30	- 32	54
増減額(含 換算差額)		+ 65	+ 33	42
現金等 期末残高		338	371	413

- 2018年度のキャッシュフロー(以下CF) について
- 営業CFは129億円のプラス(利益計上が主因)
- 投資CFは139億円のマイナス(固定資産の取得が主因)
- この結果、フリーCFは10億円のマイナス
- 財務CFは54億円のプラス
- この結果、期末の現金等の残高は413億円となった

従業員数推移



増加の主な要因は、単体従業員の増加 + 国内連結子会社の増加

注) 上記従業員は、正社員と期末時点の臨時従業員の単純合算

- 3月末の連結従業員数(正社員+期末臨時従業員)は3,123名
前年3月末比302名の増加
- 増加の主因は、単体での製造人員の増加、並びに国内連結子会社の増加

次第

- ◆ 2018年度 業績説明
- ◆ **中期目標 初年度総括**
- ◆ 中期目標 今後について
- ◆ 2019年度業績予想
- ◆ 質疑応答

長期指標：ROE10%以上

中期目標：営業利益220億円
(2020年度迄に)

両輪にて達成

売上拡大
(1,100億円を目指す)

利益率向上
(営業利益率20%以上を目指す)

- 当社は2018年5月に定量目標を開示
- 長期指標: ROE 10%以上維持
- 中期目標: 2020年度迄に営業利益220億円達成
- 売上拡大と利益率向上の両輪で達成を目指す

技術面

製品競争力強化、対象市場拡大

生産面

生産キャパシティの拡充
効率改善（自動化・省人化）

利益率改善

ERP導入による情報共有化促進
サービス（フィールド、エンジニアリング）**、消耗品売上の拡充**

中期目標達成



- 定量目標の開示と併せ、表記の全社戦略を発表
- 技術面：積極的な研究開発による、既存製品の競争力強化、対象市場拡大
- 生産面：工場新設など生産キャパシティ拡大検討
自動化や省人化を通じた生産効率改善
- 利益率改善：ERP導入による情報共有化によるビジネスの効率化
サービス及び消耗品売上の拡大

初年度は順調な進捗

定量面



2018年度ROE 14.4%, 営業利益 202億円

技術面



X線CT装置、充放電試験システムなどの展開

生産面



日野・土浦新工場着工、美山工場の稼働

利益率
改善



ERP稼働開始

○ 初年度総括：

定量面：ROE10%以上を維持、営業利益も目標へ近づいた

技術面：特に計測製品ラインナップ拡大に尽力

(X線CT装置、充放電試験システムなど)

なお、2月に株式取得した富士通コムネットワーク福島社を連結子会社化

生産面：新工場着工、美山工場の稼働など

利益率改善面：ERP稼働開始、大きなトラブルなく稼働中

キャパシティ拡充(半導体：日野工場、美山工場)

- 用地・建物取得によりキャパ拡充
- 賃貸工場(美山)も活用中



キャパシティ拡充(計測：土浦MI棟)

- 新棟(MI棟)着工 
- 2020年度稼働予定
- 各種効率化・改善策を適用予定

MI: *Monozukuri* Innovation

効率化

- ERP 稼働開始

アプリ対応強化 (台湾新アプリセンター設立)

- 予定通り進捗中
- 2020年度稼働予定

アプリ対応強化 (大阪アプリセンターリニューアル)

- 予定通り進捗中
- 2019年度稼働予定

- 半導体のキャパシティ拡充は、東京都日野市の工場用地・建物を取得、また賃貸工場(美山工場) のオペレーションも開始。
- 計測のキャパシティ拡充については、土浦工場内 新棟を着工。稼働は2020年度を予定(計画通り) 各種効率化・改善策を適用予定。

Environment(環境)

- 環境考慮製品 : LCAを考慮した環境配慮型製品の開発⇒100%対応継続 (新製品)
- 温暖化防止 : CO2排出量の削減⇒ 原単位 電力使用量の削減
- 資源削減 : 水、廃棄物 ⇒ 原単位の水使用削減、リサイクル率95%以上



Social (社会)

- サプライチェーン : ESGの強化改善を実施⇒ サプライヤCSR策定
- 女性活躍推進活動 : 女性が活躍できる会社へ⇒女性従業員による社内活動→規程改訂

Governance(ガバナンス)

- グループ行動規範 : 教育、浸透、見直し⇒HP掲載,社員教育, グループ各社展開
- コンプライアンス : 遵守体制の構築、教育、見直し⇒遵守体制構築、社員教育実施

○ 当社のESGについて行う取り組みと2018年度の実績は記載の通り

○ 今後はさらに積極的な取り組みを行いたい

次第

- ◆ 2018年度 業績説明
- ◆ 中期目標 初年度総括
- ◆ **中期目標 今後について**
- ◆ 2019年度業績予想
- ◆ 質疑応答

- **2019年度 半導体の大きな成長過程の踊り場**
- **計測は安定成長**
- **2019年度は「準備の年」**
- **財務健全性を維持しつつ、成長・開発投資は継続**



- 2019年度の業績予想は、軟調な半導体の事業環境を前提とし、減収・減益の予想しかし、長期的には底堅い需要が見込まれ、また計測事業も安定的な成長を維持すると予想
- 定量目標自体は変えず、今年度は2020年度に目標を達成するための準備の年と位置づけ、そのための設備投資や研究開発は、足許の収益によらず継続する

**世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界No.1の商品
を創り出し、皆様と共に大きく成長してゆく**

理念を示すモットー:

「WIN-WINの仕事で世界No.1の商品を創ろう」
WIN-WIN relationships create the World's No. 1 Products

コーポレートブランド:

ACCRETECH

“Accrete (共生)” と “Technology(技術)” の合成語

- 長期指標のベースにある、当社の企業理念や、枠組みに変化はない
- 企業理念は、「世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界No.1の商品を創り出し、皆様と共に大きく成長してゆく」
- これを簡潔に表すモットー、及びコーポレートブランド「ACCRETECH (アクレーテク)」を掲げ、理念の実現に取り組んでいる

企業理念実現のための枠組み



当社事業構成の特徴

半導体

- 強み：
 - 精密位置決め制御技術
 - 内製化
- チャンス：
 - 新技術・新デバイス

計測

- 強み：
 - 高精度・高分解能測定技術
 - 信頼性
- チャンス：
 - 新分野・海外需要

- バランスの取れた事業構成
 - 異なる事業領域を有することによる安定性（需要変動影響を吸収）

- 理念実現のための枠組み：
CSRやガバナンス、強固な財務基盤をベースとして
成長投資を継続し、業績拡大と企業価値の向上を実現する
- 当社事業構成の持つ強み：
半導体事業の精密位置決め制御技術や内製化、
計測事業の高精度及び高分解能を実現する測定技術とその信頼性
需要の波が異なるセグメントを有する事業構成が全社業績安定に寄与

技術面

製品競争力強化、対象市場拡大

生産面

生産能力拡充, 効率改善(自動化、省人化)

利益率改善

情報共有化促進
サービス, 消耗品売上の拡充

中期目標達成

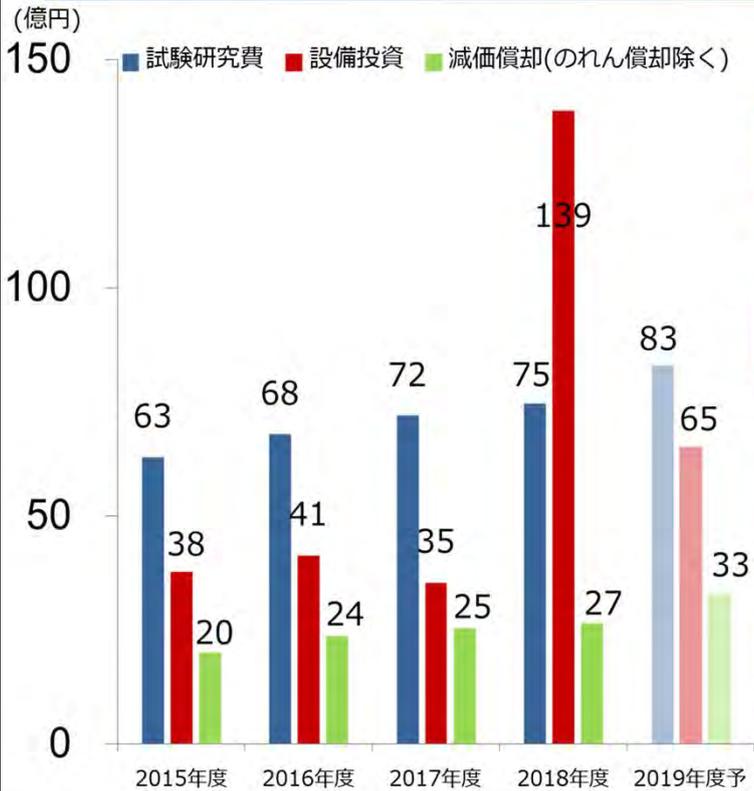


持続的な成長のために

積極的にESG活動を推進し、企業価値向上を図る

- 2019年度の全社戦略は上記の通り
- 技術面、生産面：従前より変更なし
- 利益率改善：稼働したERPを用いた情報共有化の推進
- 中期目標達成を含めた持続的な成長のための基盤として、ESG活動を積極的に推進し、企業価値の向上を図りたい

試験研究費, 設備投資, 減価償却



研究開発：製品力強化・競争力維持

➡売上高対比 10%内を目安

設備投資：能力増強、効率化等

- 能力増強：新工場
- 効率化：自動化, 加工機械投資
- アプリ対応強化：主要拠点アプリケーション

➡中期計画内で200億円超の投資を計画

減価償却

➡ERP償却を主因に増加

- 試験研究費等の2018年度実績と2019年計画
- 試験研究費：売上高対比10%を目安に強化、
2018年度 75億円、2019年度計画：83億円
- 設備投資：新工場、自動化投資など、2018年度139億円、2019年度計画 65億円
メンテナンス投資等を除き、中期目標期間内で200億円超を計画
- 減価償却(のれん償却除く)：2018年度 27億円、2019年度計画 33億円

- 財務健全性を維持しつつ、成長投資に注力
- 配当は、業績連動の利益配分を基本に連結配当性向35%を目安に実施



- 株主還元は、引き続き配当を中心に実施
- 2019年度の連結配当性向 35%を目安とする(従前は30%)
- 後述の業績予想を踏まえ、2019年度年間配当予想は 1株当たり76円

次第

- ◆ 2018年度 業績説明
- ◆ 中期目標 初年度総括
- ◆ 中期目標 今後について
- ◆ **2019年度業績予想**
- ◆ 質疑応答

半導体

- 足許は軟調だが、急な回復の可能性もある
- ベースシナリオは“冬場の受注回復”
- 受注残があり上期生産は高水準を想定

計測

- 国内は自動車インライン測定需要中心に、堅調さを維持
- 貿易摩擦、工作機械需要変動を注視
- 充放電試験システムが売上に寄与

- 半導体：足許需要環境は軟調だがお客様の投資意欲は強い
急な回復もありえるが、時期・定量水準が予想できないため
現時点では冬場の受注回復をベースシナリオとしている
- 計 測：国内自動車関連、特にインライン測定需要がけん引する見込み
一方で、工作機械需要の変動は注視したい
また2019年度より充放電試験システムの売上が寄与する前提

2019年度 業績予想



単位：億円 (配当除く)	2018年度			2019年度			
	上期	下期	通期	上期 予想	下期 予想	通期 予想	前年比
売上高	512	503	1,015	430	450	880	-13%
半導体製造装置	358	333	691	275	275	550	-20%
計測機器	154	170	324	155	175	330	+2%
営業利益	102	100	202	59	66	125	-38%
同率	20%	20%	20%	14%	15%	14%	
経常利益	108	100	208	59	66	125	-40%
当期純利益	79	68	147	42	48	90	-39%
1株配当	125円(普通配105円, 記念配20円)			76円			-49円

○ 2019年度業績予想

売上高 880億円 (2018年度比 13%減)

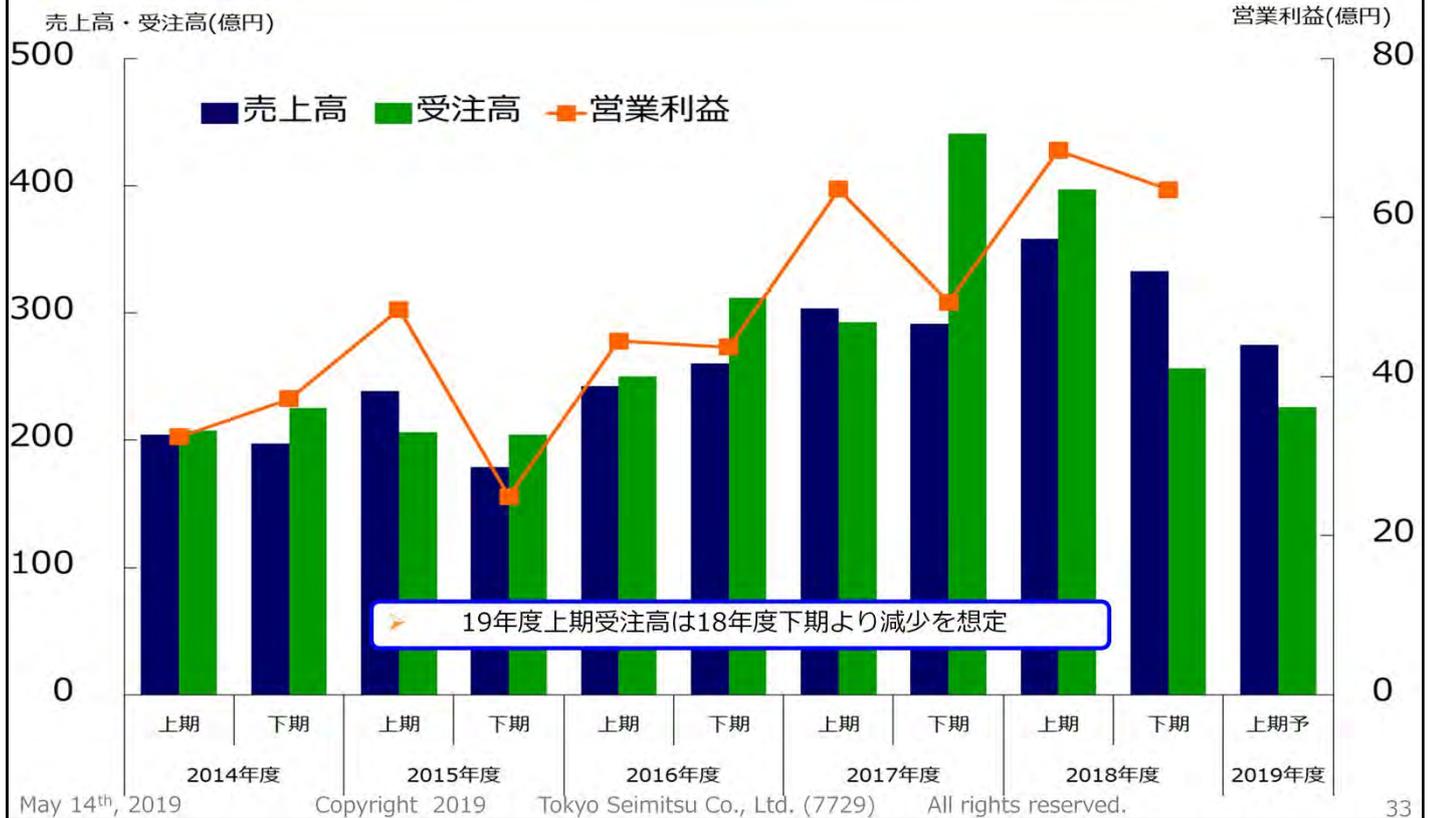
- 半導体 上期275億円、通期550億円(同20%減)

- 計測 上期155億円、通期320億円(同2%増)

営業利益 185億円 (38%減、上期59億円、下期66億円)

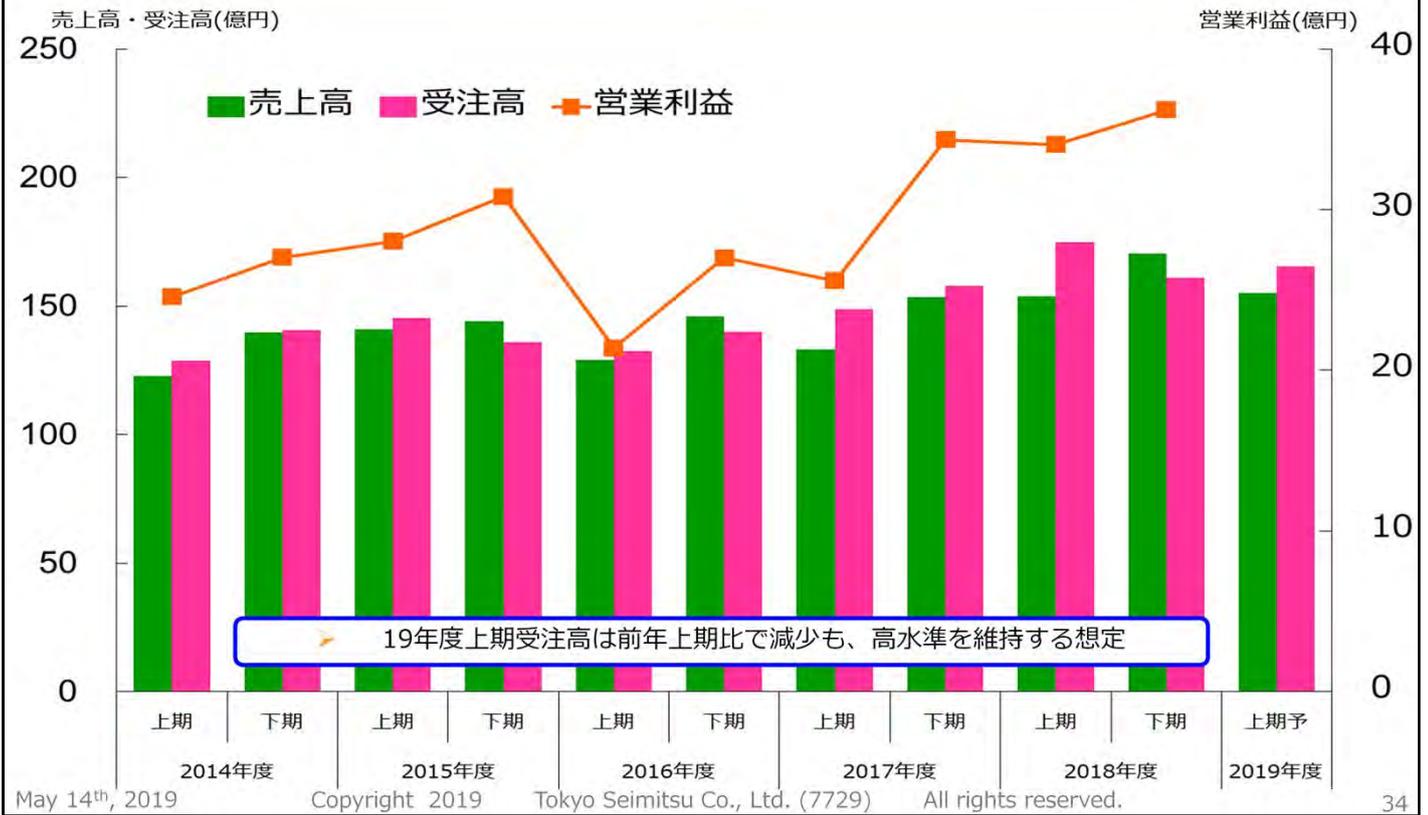
経常利益 125億円、純利益90億円

半導体 - 売上・受注高 見込



- 受注高の回復は冬場を想定、従って2019年度上期受注高は2018年度下期比減少と予想
- 2019年度上期の製品構成比の想定
 売上高：検査装置 6割台後半、加工装置 3割台前半
 受注高：検査装置 ほぼ6割、加工装置 ほぼ4割

計測 - 売上・受注高 見込



- 2019年度上期の受注高は、前年上期対比微減を予想するが基調に変化はなく、高水準を維持するものと予想
- 2019年度上期の製品構成比の想定
 売上高：汎用計測製品 6割台前半、自動計測製品 3割台後半、
 受注高：汎用計測製品 6割台半ば、自動計測製品 3割台半ば

次第

- ◆ 2018年度 業績説明
- ◆ 中期目標 初年度総括
- ◆ 中期目標 今後について
- ◆ 2019年度業績予想
- ◆ **質疑応答**



<http://www.accretech.jp/>
<https://ir.accretech.jp/ja/index.html>

